

スマートプロセス学会 論文賞 受賞者

2024年4月受賞

(敬称略)

	氏名	所属	論文タイトル	掲載号
論文賞	高尾 路茜	パナソニック ホールディングス株式会社	液相拡散接合における粒子構造が接合強度に及ぼす影響	Vol.12, No.5
	石谷 伸治	パナソニック ホールディングス株式会社		
	古澤 彰男	パナソニック ホールディングス株式会社		
	大橋 直倫	パナソニック ホールディングス株式会社		
	日野 裕久	パナソニック ホールディングス株式会社		
論文賞	森 裕幸	日本アイ・ビー・エム株式会社	遺伝的アルゴリズムを用いた非対称構造パッケージ基板の反りに対する残銅率最適化	Vol.12, No.6

2023年4月受賞

	氏名	所属	論文タイトル	掲載号
論文賞	川城 史義	東芝デバイス&ストレージ株式会社・大阪大学大学院工学研究科	アルミニウム被覆銅ワイヤによるパワーサイクル寿命向上効果	Vol.11, No.2
	吉川 雅章	東芝デバイス&ストレージ株式会社		
	三宅 英太郎	東芝デバイス&ストレージ株式会社		
	遠藤 佳紀	東芝デバイス&ストレージ株式会社		
	刀禰館 達郎	東芝デバイス&ストレージ株式会社		
	西川 宏	大阪大学接合科学研究所		
論文賞	松田 朋己	大阪大学大学院工学研究科	Ag-Cu複合焼結層の耐熱性評価	Vol.11, No.6
	山田 晴悟	大阪大学大学院工学研究科		
	廣瀬 明夫	大阪大学大学院工学研究科		
論文賞	生田 敬子	パナソニック ホールディングス株式会社	In-Situ実装ひずみモニタリングによる超音波フリップチップ接合挙動の可視化	Vol.11, No.5
	糸井 清一	パナソニック ホールディングス株式会社		
	常政 慧	パナソニック コネクト株式会社		
	櫻井 大輔	パナソニック ホールディングス株式会社		
	浅野 種正	九州大学		

2022年4月受賞

	氏名	所属	論文タイトル	掲載号
論文賞	山田 由香	大阪大学大学院工学研究科	C-H-Si非晶質薄膜を介した銅とエポキシ樹脂との接合機構	Vol.10, No.5
	福本 信次	大阪大学大学院工学研究科		
	藤本 公三	大阪大学		
論文賞	木村 文信	東京大学生産技術研究所	成形接合のメカニズム解明のための陽極酸化ポラスの相似性を維持したサイズコントロール	Vol.10, No.6
	常 昊	東京大学大学院工学系研究科		
	陳 偉彦	東京大学大学院工学系研究科		
	梶原 優介	東京大学生産技術研究所		

2021年4月受賞

	氏名	所属	論文タイトル	掲載号
論文賞	趙 研	大阪大学大学院工学研究科	電子ビーム積層造形法により作製したTiAl合金の熱間等方圧加圧法による高温疲労特性改善	Vol.9, No.4
	安田 弘行	大阪大学大学院工学研究科		
	當代 光陽	新居浜工業高等専門学校		
	上田 実	金属技研株式会社		
	竹山 雅夫	東京工業大学		
	中野 貴由	大阪大学大学院工学研究科		
論文賞	森永 英二	大阪府立大学大学院	混流生産における投入順序・部品搬送統合化計画問題の効率的解法	Vol.9, No.5
	中村 匠	大阪大学大学院工学研究科		
	若松 栄史	大阪大学大学院工学研究科		
論文賞	三ツ井 恒平	群馬大学大学院理工学府	Sn-Sb-Ag系高温鉛フリーはんだ合金の機械的性質に及ぼす微量Ni及びGe添加の影響	Vol.9, No.3
	荘司 郁夫	群馬大学大学院理工学府		
	小林 竜也	群馬大学大学院理工学府		
	渡邊 裕彦	富士電機株式会社		

スマートプロセス学会 論文賞 受賞者

2020年4月受賞

	氏名	所属	論文タイトル	掲載号
論文賞	天野 宏紀	大陽日酸株式会社, 大阪大学大学院工学研究科	レーザ積層造形における雰囲気中の酸素がスパッタ発生に与える影響	Vol.8, No.3
	山口 祐典	大陽日酸株式会社		
	佐々木 智章	大陽日酸株式会社		
	佐藤 豊幸	大陽日酸株式会社		
	石本 卓也	大阪大学大学院工学研究科		
	中野 貴由	大阪大学大学院工学研究科		
論文賞	山本 啓	大阪大学接合科学研究所	摩擦攪拌プロセスによる組織改質が低炭素鋼溶接部の破壊靱性に及ぼす影響	Vol.8, No.1
	和泉 博貴	大阪大学接合科学研究所		
	伊藤 和博	大阪大学接合科学研究所		

2019年4月受賞

	氏名	所属	論文タイトル	掲載号
論文賞	石本 卓也	大阪大学	レーザ積層造形法によるβ型 Ti-15Mo-5Zr-3Al合金の集合組織形成	Vol.7, No.6
	安富 淳平	大阪大学		
	杉本 昌太	大阪大学		
	中野 貴由	大阪大学		
論文賞	川下 隼介	鹿児島大学	パワーモジュールにおける熱サイクル試験時の封止樹脂のはく離予測評価	Vol.7, No.4
	七藏司 優斗	鹿児島大学		
	池田 徹	鹿児島大学		
	小金丸 正明	鹿児島大学		
	外園 洋昭	富士電機株式会社		
	浅井 竜彦	富士電機株式会社		

平成30年5月受賞

	氏名	所属	論文タイトル	掲載号
論文賞	八尾 崇史	大阪大学	酸化銅ペーストを用いた接合における酸化銅還元過程が接合性に及ぼす影響	Vol.6, No.4
	松田 朋己	大阪大学		
	佐野 智一	大阪大学		
	廣瀬 明夫	大阪大学		
	石井 克典	大阪大学		
	森川 千晶	株式会社リガク		
	大淵 敦司	株式会社リガク		
論文賞	屋代 恒	株式会社リガク	到達時間差法を用いたパワーモジュール内部の部分放電発生位置標定の高精度化検討	Vol.6, No.5
	秋永 優也	九州工業大学		
	真木 洵耶	九州工業大学		
	満留 博	九州工業大学		
	小迫 雅裕	九州工業大学		
	匹田 政幸	九州工業大学		
	岡本 健次	富士電機株式会社		
	池田 良成	富士電機株式会社		
論文賞	谷口 克己	富士電機株式会社	Formation of Defects in Solid-Liquid Reaction-Diffusion Bonding of Copper Using a Tin Film Interlayer	Vol.6, No.5
	中村 瑤子	富士電機株式会社		
	福本 信次	大阪大学		
	木澤 利成	大阪大学		
	松嶋 道也	大阪大学		
外園 洋昭	富士電機株式会社			
藤本 公三	大阪大学			

スマートプロセス学会 論文賞 受賞者

平成29年5月受賞

	氏 名	所 属
論文賞	谷江 尚史	株式会社日立製作所
	澄川 貴志	京都大学
	北村 隆行	京都大学
論文賞	梅田 純子	大阪大学
	藤井 寛子	大阪大学
	近藤 勝義	大阪大学

平成28年5月受賞

	氏 名	所 属
論文賞	西脇 淳人	東京工業大学
	相澤 祐輔	東京工業大学
	原田 陽平	東京工業大学
	熊井 真次	東京工業大学
論文賞	上村 泰紀	株式会社富士通研究所
	清水 浩三	株式会社富士通研究所
	作山 誠樹	株式会社富士通研究所

平成27年5月受賞

	氏 名	所 属
論文賞	依田 智子	株式会社日立製作所
	原田 正英	株式会社日立製作所
	西川 徹	日本オクラロ株式会社
	小林 竜也	群馬大学
	荘司 郁夫	群馬大学

平成26年5月受賞

	氏 名	所 属
論文賞	村田 雄一郎	三菱重工業株式会社
	伊藤 亮彦	慶応義塾大学
	閻 紀 旺	慶応義塾大学
	菅 泰 雄	慶応義塾大学
論文賞	堤 成一郎	大阪大学
	大和 真征	新日鐵住金株式会社
	後藤 浩二	九州大学
	渡邊 育夢	物質・材料研究機構
	Fionn Dunne	Imperial College London

平成25年5月受賞

	氏 名	所 属
論文賞	田中 健一郎	パナソニック株式会社
	寺田 ルリ子	大阪大学
	藤本 公三	大阪大学
論文賞	柴柳 敏哉	富山大学
	奥田 達哉	大阪大学
	塚本 雅裕	大阪大学
	阿部 信行	大阪大学
	中野 人志	近畿大学